



行业动态  
Industry News

### 陶氏电子材料为PCB市场推出新型方案

2010-11-22 | 编辑: | 【大】 【中】 【小】 【打印】 【关闭】

核心提示: 新的解决方案包括: 两种新推出的用于最终表面处理的产品; 以及四种应用于电镀和通孔金属化领域、目前处于量产测试阶段的新产品。

陶氏化学公司 (NYSE: DOW) 旗下业务部门陶氏电子材料将为印刷电路板 (PCB) 制造商带来一套新的解决方案。这些新一代技术将帮助客户不断提供具有成本效益的优质材料, 以满足未来的市场需求。新的解决方案包括: 两种新推出的用于最终表面处理的产品; 以及四种应用于电镀和通孔金属化领域、目前处于量产测试阶段的新产品。

**PCB最终表面处理:** 陶氏推出了两种在最终表面处理阶段使用的解决方案, 可在导电铜垫表面建立一层镀层, 从而带来可焊性、打线接合及保护性能。

- **AUROLECTROLESSTM SMT 520** 沉金是一种极具成本效益的解决方案, 能够在低金盐浓度下工作, 从而减少ENIG (化学镍金) 工艺中金的消耗量。该产品具有出色的沉积覆盖能力, 从而可在后续工艺步骤中增强抗腐蚀性。

- **SILVERON MFTM 100** 自催化银沉金是一种可替代浸银 (Immersion Ag) 和化学镍钯金 (ENEPIG) 的高性能解决方案。高密度的银镀层可防止铜扩散至银表面, 而减少氧化铜的形成, 因此有效的抗腐蚀性保证了良好的可焊性及铝线接合能力。在银表面加镀低厚度沉金则具有优异的金线接合能力, 高可靠度的性能是打金线技术的最新选择。

**PCB电镀:** 这两种正处于量产测试阶段的产品旨在满足高信赖度及细线路市场对电解电镀的特殊要求。在电镀阶段, 可使用这种电镀添加剂材料形成更均匀及更佳分布的铜导电层。陶氏新一代厚板铜镀 (Thick Panel Copper Plating) 可提高极厚板电镀 (厚度超过3.2 mm) 的通孔贯孔均镀能力。高速直流电铜镀 (High Speed Direct Current Copper Plating) 产品可应用于细小孔径高纵横比和微盲孔电路板, 能够在电镀密度增加的情况下仍维持很好的均镀能力。这些产品使用现有设备即可生产, 无需投资额外的设备, 产品设计均有助于提高电镀效率, 并实现更高的生产产出。

**PCB通孔金属化:** 陶氏两种正处于量产测试阶段的新产品可用于通孔金属化工艺制程, 使用这些材料形成初始沉积, 随后在其表面形成电镀层。

- 首先, 先进SAP金属化产品是一种整体SAP (半加成工艺) 解决方案。其创新的化学性质整合中和剂、整孔剂和化学镀铜。在低粗糙度下即能具有较高的绝缘层附着力, 在雷射盲孔底部和表面都具有出色的镀层覆盖力, 此外还拥

- ▣ 科普首页
- ▣ 微电子历史
- ▣ 行业动态
- ▣ 术语解释
- ▣ 无微不至
- ▣ 芯片制程
- ▣ 科普创意

有优异的镀液稳定性和可靠性能，是目前及下一代超细线路SAP的理想之选。

- 陶氏全新先进膨松剂产品可提供高成本效益、操作范围宽的卓越解决方案。新型先进膨松剂适用于普通及高性能板材，采用符合环保可持续性的溶剂及低操作浓度。

陶氏电子材料事业群电子互连技术事业部全球总经理张巍表示：“长期以来，陶氏电子材料事业群始终致力于同客户紧密合作，为这一重要市场提供先进的技术和可靠的客户服务。这些策略合作为我们客户的发展提供了保障，并有助于促进当今电子行业的重大进步。”

（来源：半导体国际 2010年11月6日）



中国科学院微电子研究所版权所有 邮编：100029

单位地址：北京市朝阳区北土城西路3号，电子邮件：webadmin@ime.ac.cn

京公网安备110402500036号